



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202975941 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220709544. 1

(22) 申请日 2012. 12. 20

(73) 专利权人 浪潮电子信息产业股份有限公司  
地址 250101 山东省济南市高新区舜雅路  
1036 号

(72) 发明人 王英华 李钟勇 于光义

(51) Int. Cl.

G06F 1/18 (2006. 01)

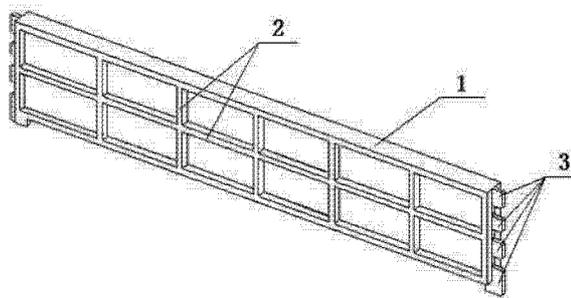
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

### (54) 实用新型名称

一种内存挡板结构

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种内存挡板结构,其结构为一块矩形板,所述矩形板同普通内存模块的外部尺寸相一致,所述矩形板上设置有加强筋,所述矩形板的两端设置有若干卡扣,所述卡扣的结构同内存插槽固定端的结构相匹配。将该挡板安装在主板上未安装内存的内存插槽上,模拟安装内存后的形态与通风,有效解决内存之间电磁波相互干扰的问题,提升整机散热效率,降低工作噪音和风扇功耗;且该挡板方便安装和拆卸,具有结构简单、设计合理、成本低廉等特点,提高了产品的竞争力。



1. 一种内存挡板结构,应用于没有安装内存的主板内存插槽上,模拟安装内存后的形态与通风,其结构为一块矩形板,其特征在于,所述矩形板同内存模块的外部尺寸相一致,所述矩形板上设置有加强筋,所述矩形板的两端设置有若干卡扣。

2. 根据权利要求 1 所述的内存挡板结构,其特征在于,所述加强筋设置个数不固定,纵横加强筋能成十字交叉设置,也能为其他设置形态。

3. 根据权利要求 1 所述的内存挡板结构,其特征在于,所述卡扣的结构同内存插槽固定端的结构相匹配。

## 一种内存挡板结构

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挡板,具体涉及一种内存挡板结构。

### 背景技术

[0002] 通常服务器的印制电路板上设置有若干内存插槽,使用时将内存条安装在这些内存插槽上,但常出现内存插槽上安装不满的情况,也就是说部分内存插槽空着。此时出现插在内存插槽上的各内存之间电磁波相互干扰的情况,同时由于不安装内存插槽区域集中过风分流,不利于其他大功率发热零件的通风散热,增大了局部散热压力影响了系统的稳定性。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的不足之处,公开一种内存挡板结构。

[0004] 本实用新型所公开的内存挡板结构,应用于没有安装内存的主板内存插槽上,该挡板采用如下技术方案解决所述问题:其结构为一块矩形板,所述矩形板同普通内存模块的外部尺寸相一致,所述矩形板上设置有加强筋,所述矩形板的两端设置有若干卡扣。

[0005] 所述加强筋设置个数不固定,纵横加强筋能成十字交叉设置,也能为其他设置形态。

[0006] 所述卡扣的结构同内存插槽的两固定端的结构相匹配。

[0007] 本实用新型公开的一种内存挡板结构的有益效果是:将该挡板安装在主板上未安装内存的内存插槽上,模拟安装内存后的形态与通风,有效解决内存之间电磁波相互干扰的问题,提升整机散热效率,降低工作噪音和风扇功耗;且该挡板方便安装和拆卸,具有结构简单、设计合理、成本低廉等特点,提高了产品的竞争力。

### 附图说明

[0008] 附图1为本实用新型内存挡板实施例的外部结构示意图;

[0009] 附图2为本实用新型内存挡板实施例的安装示意图;

[0010] 附图标注说明:1 矩形板、2 加强筋、3 卡扣、4 内存插槽、5 插槽固定端。

### 具体实施方式

[0011] 下面结合附图和实施例,对本实用新型公开的一种内存挡板结构做进一步详细说明。

[0012] 本实用新型所公开的内存挡板结构,应用于没有安装内存的主板内存插槽上,其结构为一块矩形板1,所述矩形板1同普通内存模块的外部尺寸相一致,所述矩形板1上设置有加强筋2,来模拟内存模块的表面结构增强散热效果,所述矩形板1的两端分别设置有若干卡扣3,所述卡扣3的结构同插槽固定端5的结构相匹配,以保证卡扣3能同插槽固定端5扣合固定,把所述内存挡板安装在内存插槽4内。

[0013] 所述加强筋 2 设置个数不固定,纵横加强筋 2 能成十字交叉放置,也能为其他放置形态。

[0014] 实施例:

[0015] 本实用新型所公开的内存挡板结构如图 1 所示,该内存挡板上横向设置一条加强筋 2,纵向设置五条加强筋 2,五条加强筋 2 均匀排列,横向和纵向加强筋垂直设置,所述矩形板 1 两端结构相同分别设置四个卡扣 3。使用时将该内存挡板安装在未安装内存条的内存插槽 4 上,所述内存挡板的两端卡扣 3 与插槽固定端 5 相扣合固定,如图 2 所示,这样便模拟安装内存后的形态与通风,能有效阻隔各内存之间电磁波互相干扰,防止不安装内存区域集中过风分流,保证足够的风流通过其他大功率发热器件,降低散热压力提高系统稳定性。

[0016] 在图 2 所给出的内存插槽端视图形中,显示的内存插槽结构只是普通内存插槽的示意图,不做具体内存插槽结构示范。

[0017] 以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。

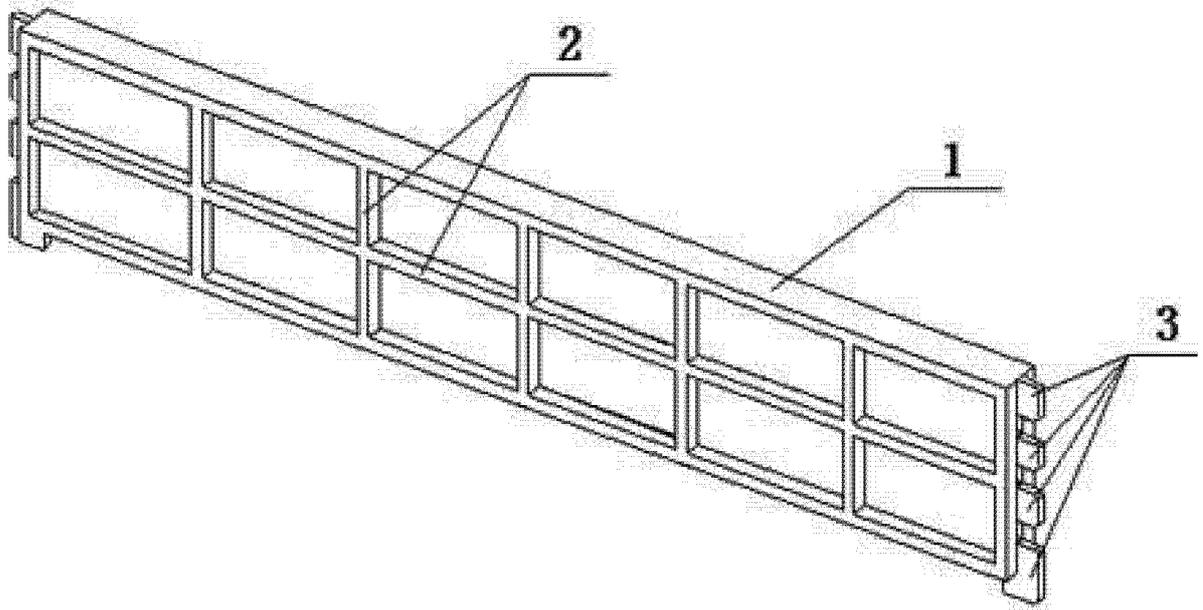


图 1

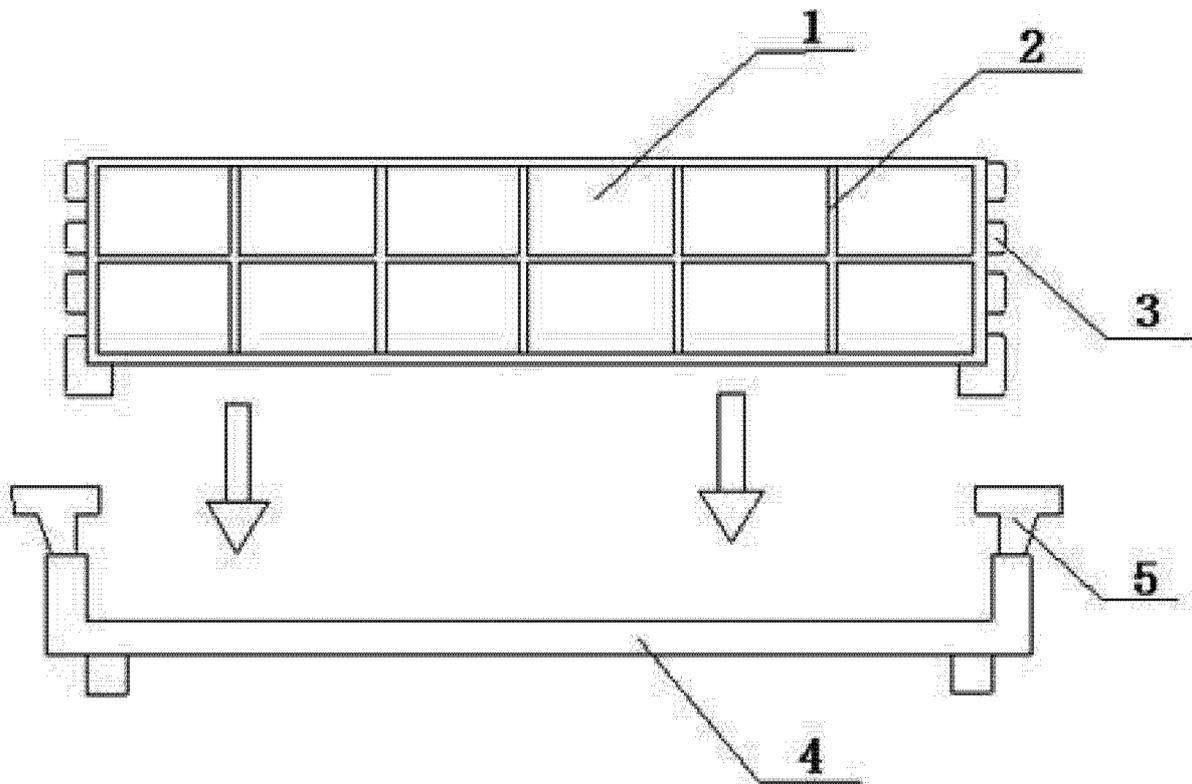


图 2